

第1回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 25 年 5 月 10 日(金) 10:30~15:10

場所:自動車会館 大会議室(2F) (東京都千代田区)

時間	題 目	講 演 者
10:30~ 10:35	委 員 長 挨 拶	
10:35~ 11:55	司会 福本信次 (大阪大学)	
	『パワーチップとパッケージの絆』 (40分)	三菱電機(株) ○湊 忠玄
	『JEITA 環境調和型先端実装技術の 活動概要と国際標準化』 (40分)	JEITA 実装技術標準化専門委員会 ○荒金 秀幸
11:55~ 12:55	昼 食 休 憩	
12:55~ 13:00	委 員 会 議 事	
13:00~ 15:10	司会 井上雅博 (群馬大学)	
	『ADEKAの実装プロセス材料 ー実装樹脂材料および回路形成薬液ー』 (40分)	(株)ADEKA ○森 貴裕
	Mate2013技術開発論文賞 受賞講演 『Cuピラー/Sn-Biはんだフリップチップ 接合部のエレクトロマイグレーション現象』 (30分)	新光電気工業(株) ○村山 啓
	Mate2013 開発奨励賞 受賞講演 『ガラスフリット入り Ag ペーストを用いた Al 表面上の Ag 焼成膜形成技術の開発』 (30分)	三菱マテリアル(株) ○西元 修司
	Mate2013開発奨励賞 受賞講演 『フォトシタリングを利用した導電性 銅ナノインクの焼結と焼結銅皮膜の特性』 (30分)	石原薬品(株) ○川戸 祐一

( )内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

平成  
25  
年  
5  
月  
10  
日  
金  
曜  
日

# 自動車会館 会場案内図

